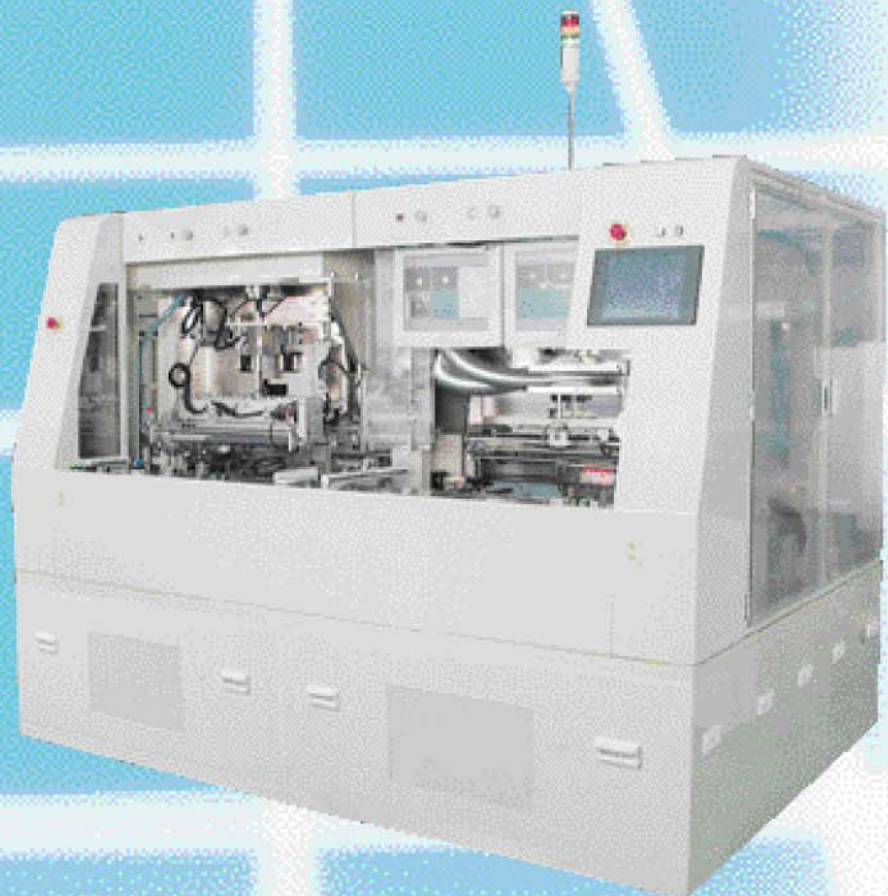


本装置はLCDパネルにPCBをACFテープを介して接続する装置です。
オペレータによりLCD及びPCBをセットし、その後のACF仮圧着、ワークのアライメント、本圧着を自動で行います。

This is the semi-automated PCB bonding system equipped ACF attaching device(Pre-bonding) and Final bonding device, which performs a joining PCB to LCD withTCP.
Once an operator manually places PCB and LCD with TCP on the stage,then pushes the button to start, the machine automatically performs attaching ACF on PCB, positioning PCB and LCD with TCP by high precision recognition camera and final bonding.

TTP-H10

セミオートPCB圧着装置



特長

- 1) 7.8"から21"のLCDパネルに対応。
- 2) 治具を簡略化しランニングコストと機種切替時間を低減。
- 3) PCBトレーローダーより自動供給が可能。(オプション)

FEATURES

- 1) Capable of bonding 7.8" to 21" LCD panels.
- 2) The simplified PCB related Zig can realize cost reduction and rapid production changeover.
- 3) Optional "PCB Tray Loader" enables supply of PCB to the main machine.

項 目		TTP-H10	
LCD対応サイズ		7.8"~21.0"	
PCBサイズ		190mm×480mm×12mm~100mm PCB厚さ0.5mm~2.0mm 部品高さ MA×4mm	
スループット		40秒/1辺(但し、2回目セット以降)ワークセット・リセット含まず	
搭載精度		ACF貼付	本 圧 着
		X方向:±0.5mm Y:±0.2mm	X方向:±20μm Y方向:±50μm
ヒーター方式		コンスタントヒート方式	
ヒーター温度(設定)		MAX 200°	MAX 500°
加圧力(実効推力)		200~2500N	200~4500N
加熱時間		000.0~999.9秒	000.0~999.9秒
ツール長さ		540mm	540mm
緩衝材		2層 自動巻取り	3層 自動巻取り
バックアップ		SUS製	SUS製
貼付		ハーフカット	
貼付長さ		100~540mm	
圧力管理		エア-圧力管理	
圧力方法		低摩擦エア-シリンダー	
ユーティリティ	電 源	φ3 AC200V±10% 60Hz 30KVA	
	エア-源	0.5Mpa以上 約200NL/min	
	真空源	真空エジェクター内蔵	
装置サイズ		(W)2500mm×(D)1800mm×(H)1900mm	
装置重量		約2500kg	

※外観・仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。

ITEM		TTP-H10	
Applicable LCD size		7.8"~21.0"	
PCB size		190mm×480mm×12mm~100mm PCB Thickness 0.5mm~2.0mm Parts height MA×4mm	
Through put		40sec./1side(But,2nd set or later) Not include work set and reset	
Loading accuracy		ACF PRE BONDING	
		X direction:±0.5mm Y direction:±0.2mm	X direction:±20μm Y direction:±50μm
Heater		Constant heat method	
Heater temperature(Set Value)		MAX 200°	MAX 500°
Bonding Pressure		200~2500N	200~4500N
Heating time		000.0~999.9 sec	000.0~999.9 sec
Tool Length		540mm	540mm
Cushion		2 layers Automatic winding	3 layers Automatic winding
Back up		SUS	SUS
Attaching		Half cut	
Attaching length		100~540mm	
Pressure management		Air pressure management	
The pressure method		Low friction air cylinder	
Utility	Power Supply	φ3 AC220V±10% 60Hz 30KVA	
	Air source	Over 0.5Mpa About 200NL/min	
	Vacuum source	Vacuum Ejector internal organs	
Machine Size		(W)2500mm×(D)1800mm×(H)1900mm	
Machine weight		About 2500kg	

※Specifications are subject to change without prior notice.

HP : <http://www.takatori-g.co.jp> E-mail : info@takatori-g.co.jp

Takatori Corporation

■本社・工場
〒634-8580 奈良県橿原市新堂町313-1
TEL.(0744)24-6608 FAX.(0744)24-8352

■Head Office
〒634-8580 313-1, Shindo-cho, Kashihara City, Nara Pref., Japan
TEL.++81-744-24-6608 FAX.++81-744-24-8352